

マイクロ・ナノスケール微細加工の表面界面先端技術

Advanced Surface and Interface Technologies for Micro and Nanoscale Fabrication

フォトリソグラフィや電子線描画等の微細加工技術によって作製されるマイクロからナノスケールの先端デバイスの微細化と高機能化は進展を続けています。それを支える要素技術は様々ありますが、特に表面界面技術に注目して、材料選定、合成、成膜、エッチング、パッシベーション等の各プロセスにおける表面処理と界面制御の最新技術とそれらを駆使して実現される先端デバイスについてご紹介いただきます。

日時：2023年3月16日（木）13:30~18:25

会場：ハイブリッド開催（上智大学 四谷キャンパス 6号館 A302&オンライン）

プログラム(敬称略)

13:30-14:05【招待講演】三田 吉郎（東京大学）

エネルギー自立分散ロボットに向けた集積 MEMS テクノロジ

14:05-14:40【招待講演】鈴木 孝明（群馬大学）

3次元リソグラフィ技術を用いたメカニカルメタマテリアル発電

14:40-15:15【招待講演】年吉 洋（東京大学）

シリコン酸化膜エレクトレットのMEMSアクチュエータ・
エナジーハーベスタ応用

15:15-15:50【招待講演】ティクシエ 三田 アニエス（東京大学）

Bio-sensors based on Thin-Film-Transistor Technology

15:50-16:05 休憩

16:05-16:40【招待講演】渡邊 健夫（兵庫県立大学）

EUV リソグラフィ技術開発の現状および今後の展開について

16:40-17:15【招待講演】酒井 啓太（キヤノン株式会社）

半導体デバイス製造用ナノインプリントリソグラフィの開発状況

17:15-17:50【招待講演】浅川 鋼児（キオクシア株式会社）

半導体リソグラフィの微細化、エッチング耐性の限界を打破する
「プラス α 」技術：誘導自己組織化(DSA)と逐次浸透合成(SIS)

17:50-18:25【招待講演】張 文馨（産総研）

CFET 性能バランス整合に向けた三次元異種チャンネル集積技術

世話人

浅沼 周太郎（産総研）

曾根 逸人（群馬大学）

企画

薄膜・表面物理分科会

2/3 版

